

2021年12月電子デバイス研修講座(専門講座)：WEB配信併用

電子デバイス研修講座(専門講座)：WEB併用	
キャッチフレーズ	<p><b>3D パッケージングと実装技術の進化 ～半導体産業の構造変化が起きている～</b></p> <p>3D パッケージング技術と実装技術が今後の半導体産業の発展に重要な役割を果たすようになってきました。証券会社のアナリストの見方、5Gスマホ・自動上店に必要な技術、欧米の技術開発状況を確認しながら今後の産業構造と技術動向を議論したいと考えています。少し詳細技術になりますが、INTEL EMIB用のリジッドサブストレートの製造技術についても解説していただきます。</p>
対象者	半導体パッケージングと実装技術の、材料、装置、プロセスに関するの中堅・経験のあるエンジニアと事業企画ご担当 同時に半導体のユーザーや電子機器のセットメーカーの方にとってもお役に立つと考えています。
会場	学士会館203号室
WEB参加の場合	Teamsを使用しURLを送付し、接続していただきます。
12月1日 (水)	<p>10:10-10:50 <b>半導体実装技術の推移と技術課題</b> 加藤凡典 有限会社 エー・アイ・ティ 1960年代に日本でも製造が始まった半導体のパッケージング及び実装技術の推移と現在抱えている技術課題について整理します。</p>
	<p>11:00-12:00 <b>証券市場から見る半導体産業構造の変化</b> 山本義継 みずほ証券 半導体実装にかかわる装置・材料メーカーの今後と産業構造の変化について証券アナリストとしてコメントしていただきます。</p>
	<p>12:00-12:50 昼食・昼休み</p>
	<p>12:50-13:50 <b>5Gスマホ及び自動運転における実装技術のキーポイント</b> 上田弘孝 セミコンサルト 5G用スマホ及び自動運転には新しい実装技術が多く使われています。本格的5Gの時代に向けて必要となる実装技術のキーポイントを解説していただきます。</p>
	<p>14:00-15:00 <b>ヘテロジニアス・インテグレーション</b> 宇都宮久修 インターコネクションテクノロジー アメリカにおけるITRSの考え方、Intel AMDなどの chipletの現状などヘテロジニアスインテグレーションの現状を解説して頂きます。</p>
	<p>15:10-16:10 <b>ドイツ IZM ASSID における研究開発</b> 横内貴志男 関東学院大学 IEEE フェロー 先端半導体実装技術開発では世界で最も進んでいる研究機関のひとつであるドイツIZM ASSIDの開発状況について解説して頂きます。</p>
	<p>16:20-17:10 <b>パッケージサブストレート用リジッド基板の技術課題</b> 小山昌一 サークル エス R&amp;C 半導体パッケージサブストレート用リジッド基板の製造技術とその技術課題について解説して頂きます。</p>